

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

# 合肥新汇成微电子股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

### (2023年9月19日)

编号：2023-010

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国泰君安、浙商证券、德毅资产、弥远投资、旌安投资、上银基金等（排名不分先后）
活动时间	2023年9月19日
活动地点	公司会议室、线上会议系统
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 奚颢 投资者关系经理 齐博
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>1、问：公司近期稼动率情况如何？目前订单能见度及Q4展望情况如何？</p> <p>答：公司Q3稼动率处于相对较高水平，订单能见度大约2-3个月，以现有客户订单指引来看Q4稼动率有望继续保持相对较高水平。</p> <p>2、问：公司封测业务价格是否有变动？预计明年是否有价格上涨的空间？</p> <p>答：今年年内封测业务价格整体维持稳定，短期内价格大幅波动的可能性不大，明年的价格趋势主要取决于市场</p>

	<p>环境，暂无法准确估计。公司将通过调整产品结构提升盈利水平。</p> <p><b>3、问：公司所处细分领域人员流动性如何？</b></p> <p>答：公司核心管理团队及技术研发人员在近年内整体维持稳定。公司所处行业属于技术密集型行业，对于技术人才的知识背景、研发能力及工作经验均有较高要求，因此公司对人才培养和留任格外重视，在不断完善内部培训和管理制度的同时，也通过股权激励等手段吸引优秀人才及稳定核心团队，为公司的可持续发展奠定基础。</p> <p><b>4、问：公司最近公告的合肥二期项目主要用于承接哪些业务？</b></p> <p>答：公司近期公告的合肥汇成二期项目占地约 57 亩，计划分阶段进行投资建设。第一阶段总投资约 10 亿元，主要用于拓展先进封装测试产能，并依托现有技术延伸产线工艺至车载芯片封装测试等领域。公司拟在项目第一阶段先行投资约 6 亿元用于新建车载显示芯片项目，后续投资计划将根据项目投产情况及市场环境等因素另行确定。</p>
附件清单（如有）	无
上传日期	2023 年 9 月 21 日